



UV解黏膠帶應用於:玻璃裁切保護、拋光、研磨、顯影、切割製程，小面積銅箔及PCB切割製程。

UV解黏膠膜產品特點:

1. 照射UV後，黏度極低，且不留殘膠。
2. 照射UV反應時間快速，有效提升工作效率。
3. 特殊黏膠配方、黏著力佳，切割時不會飛散。
4. 特殊結構設計，降低影響切割刀壽命。

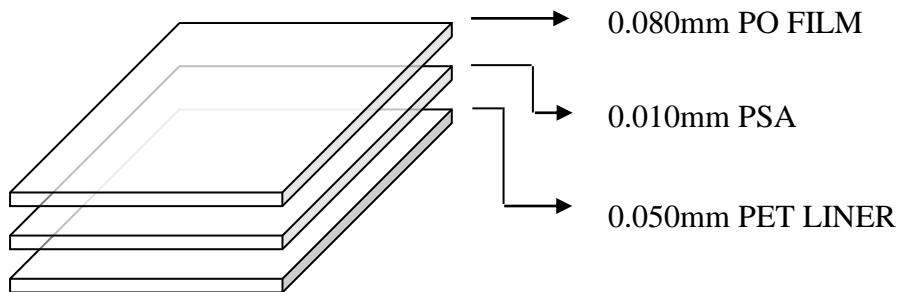
REVP8530 測試報告

一、目的：針對製品貼著鋼板、晶圓後物性分析

二、測試項目：黏著力、解黏後黏著力(500mJ/cm^2)

三、測試方法：黏著力使用 1inch 寬測試、貼著晶圓、鋼板 20 分後測試物性

四、產品架構：



五、結論：

1. 製品 REVP8530 測試被貼物鋼板、晶圓 2 種黏著力時，測試中並無殘膠現象，撕除後也沒有殘膠問題產生。

2. 物性測試如下表：

表一、數據表現

貼著物	鋼板		晶圓	
	解黏前 黏著力 (g/inch)	解黏後 黏著力 (g/inch) (500mJ/cm^2)	解黏前 黏著力 (g/inch)	解黏後 黏著力 (g/inch) (500mJ/cm^2)
測試				
REVP8530	996 901 959	12 9 13	755 768 762	3 4 4